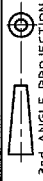


NUMBER 178307

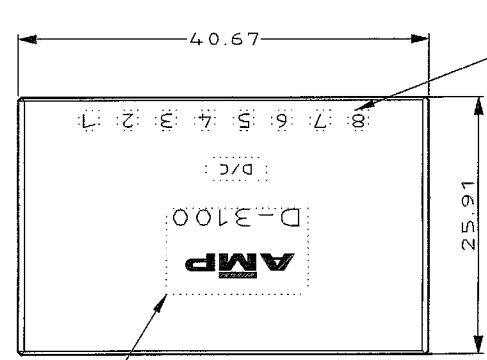


METRIC

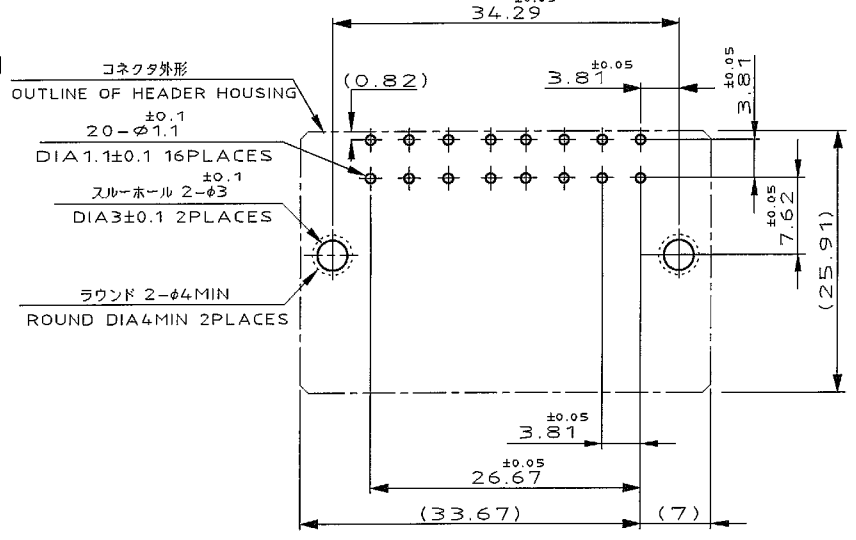
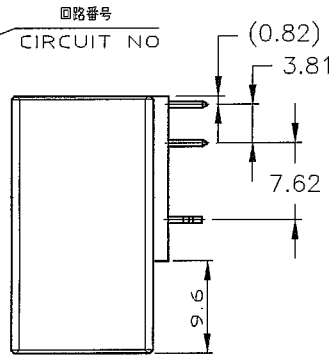
DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J REV.10/83



AMPマーク
シリーズマーク
SERIES MARK

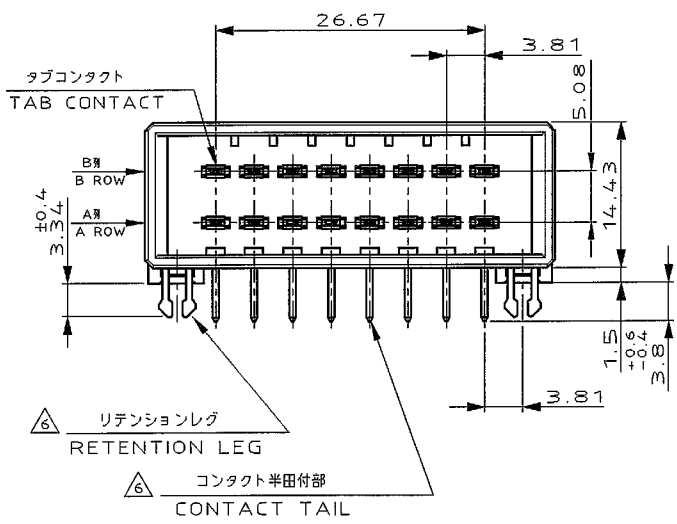


推奨基板取付け寸法

PC 基板厚: 1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN

PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)



NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILED THERMO PLASTIC, POLYESTER COLOR: BLACK
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 色: 黒
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38 μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76 μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の上に半田めっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部: ニッケル下地の上にスズめっき

△6	△4	178307-5
△6	△3	178307-3
△6	△2	178307-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

C	REVISED (FJ00-0039-03)	T S M	4/2	4/15	
B	REVISED (FJ00-0097-03)	T S M	4/15	10/9	
A	REDRAWN (FJ00-2183-95)	K . I S M	3/23	3/95	
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE	

Copyright © 1993
AMP (Japan) LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.

tyco Electronics
Tyco Electronics AMP K.K.
Kawasaki, Japan

WIRE RANGE: mmT(AWG) - mmφ
INSULATION DIA: mmφ
NAME: タイナミック D3100 水平タイプ 16 極 ヘッダーアセンブリー
16 POS DOUBLE ROW
HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100

MATERIAL: SEE NOTE
FINISH: SEE NOTE

DR. 16/MAR/95 K.IKEDA
DE. 16/MAR/95 K.IKEDA
CHK. S.MANABE
APP. 23/MAR/95 S.MANABE

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)
10桁: ±0.3
10桁 3桁: ±0.4
3桁 10桁: ±0.45
桁: ±0.3

SIZE LOC NUMBER: A3 J
SCALE: 2-1
REV. C
SHEET 1 OF 1

Part Number: C-178307

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面